

次世代スーパーコンピュータの分野で絶賛される

マイクロンのハイブリッドメモリキューブ

マイクロンの新デバイスは、ペタスケールスーパーコンピューティングをサポートし、

メモリの壁を打ち破ることで、スーパーコンピュータに関する

業界最大の課題を解決

米アイダホ州ボイシー、2013年11月8日(GLOBE NEWSWIRE) -- マイクロンテクノロジー社 (Nasdaq:MU) は本日、同社のハイブリッドメモリキューブ(HMC)をペタスケールスーパーコンピュータシステムに採用する計画であると発表し、メモリテクノロジーにおける飛躍的な前進を示しました。HMCは低消費電力かつ高帯域幅でメモリにアクセスすることが必要なアプリケーション向けに設計されており、これはスーパーコンピュータの最も重要な要件です。他のアプリケーションとしては、データパケット処理、データのパケットバッファまたはストレージ、およびプロセッサのアクセラレーションなどがあります。

マイクロン、およびスーパーコンピュータの世界的なリーダーである富士通は、11月19日から21日までデンバーで開催される2013年スーパーコンピューティング会議において、富士通の次世代スーパーコンピュータの試作品に使用したHMCデバイスを紹介するディスプレイボードをそれぞれ展示する予定です。

スーパーコンピューティングは、科学者やエンジニアが複雑なシミュレーションに取り組むことで研究開発を推進し、宇宙のつくりに関する根本的な疑問を調査するために不可欠なテクノロジーです。このように大規模な課題に取り組むためには膨大なデータを移動させる能力が必要ですが、HMCを使用することで、スーパーコンピュータのマルチコアプロセッサのアーキテクチャが持つ潜在能力を解き放ち、非常に優れた能力効率を実現することができます。

マイクロン DRAM ソリューショングループ担当副社長の Brian Shirley 氏は次のように述べています。「富士通の設計者およびエンジニアの皆様は、ハイブリッドメモリキューブを用いて同社のシステムを次のレベルへ引き上げることの重要性を早くから認めていらっしゃいました。

コンピューティングにおける最先端の課題に向けて、富士通がその能力を早急に向上させるために私たちがご協力できることと思います」

富士通の次世代テクニカルコンピューティングユニットのリーダーである追永勇次氏は次のように述べています。「HMCは帯域幅、非常に小型のフォームファクタ、ビットあたりの最適消費電力に対する需要の増加に応える新しいメモリシステムの設計を可能にすることから、当社のシステム設計者は非常に感心しています。アプリケーションソフトウェアの最適な性能効率を実現するためにはB（バイト）/F（フロップ）率を改善することが重要ですが、HMCはスーパーコンピューティングのためのメモリ性能における新たな基準を示しています」

業界の画期的ソリューションであるHMCは、先進のスルーシリコンビア（TSV）を使用しています。TSVは積み重ねられたチップを電気的に接続する垂直なコンジットで、高性能ロジックとマイクロンの最新鋭DRAMを組み合わせました。マイクロンのHMCは、160GB/sというかつてないメモリ帯域幅をご提供すると同時に、既存のテクノロジーと比較してビットあたりで最大70%の消費電力削減を実現するため、お客様の総保有コスト(TCO)を劇的に削減します。

HMCは業界のリーダーや業界に影響をもたらす企業において、DRAMの性能向上レートとプロセッサのデータ消費レートとの間で広がり続ける格差に対する待望のソリューションであることが認められています。マイクロンのHMCは先日、エレクトロニクス系の主要な出版物であるEDN誌およびEE Times誌により、『メモリ製品オブ・ザ・イヤー』に選出されました。

マイクロンは、2014年末に2GBおよび4GBのHMCの量産を開始する予定です。

## マイクロンについて

マイクロンテクノロジー社は、先進的な半導体ソリューションを提供する世界的な大手企業です。マイクロンは、世界全域での事業活動を通じ、最先端のコンピューター、家電製品、ネットワークキング、組み込み製品、モバイル機器などに使用されるDRAM、NANDおよびNORフラッシュメモリ全般、およびその他の革新的メモリ技術、パッケージングソリューション、半導体システムなどを製造・販売しています。マイクロンテクノロジー社の普通株式はNASDAQにMUのコード名で上場取引されています。マイクロンテクノロジー社に関する情報は[www.micron.com](http://www.micron.com)をご覧ください。

© 2013 年 Micron Technology, Inc. All rights reserved. 情報は予告なく変更されることがあります。マイクロンおよびマイクロンの軌道ロゴは Micron Technology, Inc.の商標です。その他のブランド名および製品名はすべて、それぞれの所有権者の商標ないし登録商標です。このニュースリリースには、ハイブリッドメモリキューブのサンプルの入手可能性および量産に関する将来予測の記述が含まれています。実際の出来事や結果は、将来予測の記述に含まれる内容と大きく異なる可能性があります。マイクロンが米証券取引委員会に対し随時提出する連結ベースの書類、具体的にはマイクロン最新のフォーム「10-K」と「10-Q」をご覧ください。これらの書類は、マイクロンによる連結ベースの実際の結果と「将来予測」に記載されたものが大きく異なる原因となり得る重要な要因を含むと共に、それらを特定しています（「特定の要因」を参照）。当社は「将来予測」に示された期待は妥当だと考えておりますが、将来の結果、活動のレベル、実績、あるいは成果を保証するものではありません。

お問い合わせ先: マイクロン メディア担当 :

Scott Stevens

+1-512-288-4050

sstevens@micron.com